

2022年4月1日

三菱ガス化学株式会社

## 台湾の聯茂電子股份有限公司との合弁会社設立について

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：藤井 政志）は、台湾の電子材料メーカーである聯茂電子股份有限公司（董事長：陳進財、以下、聯茂）とプリント配線板用積層材料を製造販売することを目的とした合弁会社を2022年3月31日に設立いたしましたのでお知らせいたします。

当社機能化学品事業部門 電子材料事業部では、当社独自のBTレジンを用いた高耐熱性、低熱膨張性を特徴とするプリント配線板用積層材料を半導体パッケージ基板用途に展開し、これまでにスマートフォンやパソコン、自動車などの半導体用途に幅広く採用され、市場で高く評価されています。

半導体市場は、IoTに伴う各種センシング技術の活用、データセンターの増設、5G移動通信システムの本格的普及、自動車業界における技術革新（CASE/ADAS）などによって後押しされ、今後益々伸長していく事が期待されています。

当社と聯茂は本合弁会社の設立を通じて、両社が有する技術や設備、知見を活用し、合弁会社独自の半導体パッケージ基板用積層材料の新製品を提供することで、今後も拡大し多様化していく半導体市場の要求に応えてまいります。

### <合弁会社の概要>

会社名：菱茂電子科技股份有限公司（英語名 MGC-ITEQ Technology Co., Ltd.）  
所在地：新竹縣新埔鎮内立里大魯閣路17號（聯茂 本社内）  
資本金：100百万ニュー台湾ドル  
出資比率：当社51%、聯茂49%  
董事長：東 友之  
事業内容：半導体パッケージ基板用途を主体とするプリント配線板用積層材料の製造販売

### <聯茂電子股份有限公司の概要>

会社名：聯茂電子股份有限公司（英語名 ITEQ CORPORATION）  
所在地：新竹縣新埔鎮内立里大魯閣路17號  
設立：1997年4月10日  
資本金：3,830百万ニュー台湾ドル  
売上高：32,525百万ニュー台湾ドル（2021年12月期）  
董事長：陳進財  
事業内容：プリント配線板用銅張積層板およびプリプレグの製造販売  
従業員数：3,903名（2022年3月末現在）

以上

### 本件に関するお問い合わせ先

三菱ガス化学株式会社 総務人事部広報グループ  
TEL：03-3283-5040 <https://www.mgc.co.jp>